

平成22年度第2回 次世代戦略技術実用化開発助成事業 採択課題一覧

	事業者名	開始期間	事業名	事業概要
1	富士通株式会社	H23.3～	高速コンピュータ用内蔵デカップリングキャパシタの開発	自動車・航空宇宙・医療など高度なシミュレーションを駆使したもののづくり関連技術推進を担う高性能スーパーコンピュータの実現のために、高速LSIに適した高性能デカップリングキャパシタの開発を実施する。この開発によりLSIへの電源供給効率が向上し、次世代のコンピュータの高速化・省エネ化を実現できることになる。
2	旭化成ケミカルズ株式会社	H23.3～	二酸化炭素を原料とする化学品製造プロセスの研究開発	有用な化学品をグリーンプロセスで製造することを実現するために、二酸化炭素を原料とする化学品製造プロセスの研究開発を実施する。この開発により、ポリカーボネート等のポリマーや化学品の原料である炭酸エステル類を、二酸化炭素を原料として用いて製造するプロセスができることになる。
3	住友精密工業株式会社	H23.3～	航空機エンジン用熱交換器 Advanced Structural Surface Cooler (ASSC) の実用化開発	一般的にサーフェイス・クーラーと呼ばれる航空機エンジン用熱交換器はエンジン外周のファン・ケースに搭載されている。環境にやさしい航空機エンジンを実現するために、エンジン内部のコア・フェアリングと一体化された高性能熱交換器の開発を実施する。この開発によりファン・ケース重量を低減し、燃費向上及び有害物質低減ができることになる。
4	株式会社松栄工機	H23.3～	動力伝達に、永久磁石を用いた次世代環境型出力切替機構の事業化	主に車載用のクラッチ部品に最適な、省エネ化と環境に配慮した次世代環境型／新出力切替機構の実用化開発を実施する。これは動力伝達部に非接触で対向させた永久磁石と磁性体間の磁気結合構造に新たに今回開発した新構想を盛り込んだもので、この開発により「低エネルギーロス、高度な安全性、且つ静寂性と切り替え時の振動・衝撃フリー」の実現が可能になる。
5	日本ベル株式会社	H23.3～	超高感度・迅速比表面積・細孔分布測定装置開発	従来材料の比表面積や細孔分布測定は、窒素吸脱着等温線を測定し、各種理論により解析されてきた。この測定にはサンプル量を約0.1gそして1～2日を必要とする。本開発は水晶振動式マイクロバランス(QCM)技術を用い数 μ g程度のサンプル量で迅速かつ省力的でありながら高精度・高信頼性の評価を可能とする。
6	株式会社オキサイド	H23.3～	次世代半導体プロセス対応全固体DUVレーザー光源の開発	次世代半導体プロセス対応の高信頼性レーザー光源を実現するため、全固体連続波深紫外レーザー装置の長寿命化、高出力化を図る。非線形結晶デバイスと共振器構造の改善と、結晶シフトおよび高出力基本波光源の開発を行なう。これにより、次世代半導体製造や通信デバイス製造などにおける生産性を大幅に向上することができる。